

# 2016-2022年中国集成电路 封装市场调查与前景趋势报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

## 一、报告报价

《2016-2022年中国集成电路封装市场调查与前景趋势报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/T61651NLM3.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

集成电路又称芯片，是工业生产的“心脏”。由于起步较晚，我国集成电路产业价值链核心环节缺失，产业发展远不能支撑市场需要。而2014年以来，对于集成电路产业的支持信号正在进一步释放。《国家集成电路产业发展推进纲要》明确了我国集成电路产业发展的四大任务：着力发展集成电路设计业、加速发展集成电路制造业、提升先进封装测试业发展水平、突破集成电路关键装备和材料。《国家集成电路产业发展推进纲要》还提出，到2015年建立与产业发展规律相适应的融资平台和政策环境，集成电路产业销售收入超过3500亿元；2020年与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%；2030年产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越式发展。

近年来中国电子工业持续高速增长，集成电路产业进入快速发展期。

近年来中国集成电路行业持续快速增长，几家行业龙头企业实力增势显著，中国市场已成为全球集成电路市场增长的主要推动力之一，随着本土集成电路龙头企业的不断崛起，未来全球产业竞争格局有望迎来一轮洗牌。2015年上半年中国集成电路产业在设计业、制造业快速增长带动下增速较快，上半年中国集成电路产业销售额为1591.6亿元，同比增长18.9%。其中，设计业销售额为550.2亿元，同比增长28.5%；制造业销售额395.9亿元，同比增长21.4%；封装测试业销售额645.5亿元，同比增长10.5%。截至2014年底，中国占全球半导体消费市场的份额已达到了创纪录的56.6%。过去11年中国市场复合年增长率达到了18.8%，而同期全球芯片消费的复合年增长率仅为6.6%。作为全球电子产品制造大国，近年来中国电子信息产业的全球地位迅速提升，产业链日渐成熟，为我国集成电路产业发展提供了机遇。特别是2014年《国家集成电路产业推动纲要》的细则落地，大基金项目启动，地方各基金纷纷建立，更是推动中国集成电路产业迎来新的黄金发展期。预计2015年，国内产业销售收入将达到3300亿元，年平均增长率达到18%。我国极大规模集成电路制造工艺获突破，一批65-28纳米高端设备通过量产验证，而部分实现批量采购，40纳米成套工艺成功量产。我国已经在集成电路高端装备、成套工艺、关键材料、封装测试等领域取得了部分突破。除了上述制造工艺突破，光刻机整机集成及零部件技术水平也得到迅速提升，封测产业加速升级，专项成果辐射相关产业应用。旺盛的国内市场需求也是发展我国集成电路产业的强大动因。

中国集成电路设计行业呈现高度市场化的特征。一方面，从事集成电路设计的国内企业数量众多，竞争较为激烈；另一方面，国外的众多IC设计企业纷纷涌入中国市场，其中不乏具有较强资金及技术实力的知名设计公司，进一步加剧了中国市场的竞争。目前，在中国电容式触摸屏控制芯片市场上，欧美企业拥有技术优势，在系统噪声处理、灵敏度、稳定度、分辨率等方面有一定的技术积累，如ATMel、Cypress、Synaptics等，都具有较强的竞争实力。而

随着近年来中国电容式触摸屏控制芯片市场的高速成长，各IC设计公司均加大了对电容式触摸屏控制芯片的研发投入，以期通过产品优势来占据更多的市场份额。

国内集成电路产业的不足之处还体现在产业布局不集中、投入严重不足和核心技术、关键设备受制于人等方面，我国集成电路产业发展的生态环境亟待优化，设计、制造、封装测试以及专用设备、仪器、材料等产业链上下游协同性不足，芯片、软件、整机、系统、应用等各环节互动不紧密。IC设计和芯片制造业在我国的迅猛发展，使得国内集成电路产业已经形成了IC设计、制造、封装测试三业及支撑配套业共同发展的较为完善的产业链格局。作为信息技术产业的核心，集成电路产业的加快发展，能带动我国的经济转型升级，也是提升国家信息安全的重要保障。

目前，我国集成电路产业规模仍然较小，仅占全球市场的10%左右。我国是全球最大的集成电路市场，但自行设计生产的产品只能满足市场需求的五分之一，CPU、存储器等通用芯片主要依靠进口，国内通信、网络和消费电子等产品中的高档芯片也基本依靠进口。我国集成电路产业面临的第二个问题是创新不足，表现为我国集成电路企业以中小型企业为主。企业力量分散，国内500多家设计企业总收入不及高通公司收入的一半；主流产品设计技术水平仍为中低端，制造工艺与国际先进水平差两代，新型高端封装技术仍很欠缺，难以满足产业发展需求。集成电路产业价值链整合程度还不够，产业链还不完善。

智研数据研究中心发布的《2016-2022年中国集成电路封装市场调查与前景趋势报告》依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！

智研数据研究中心是国内权威的市场调查、行业分析专家，主要服务有市场调查报告，行业分析报告，投资发展报告，市场研究报告,市场分析报告,行业研究报告,行业调查报告,投资咨询报告,投资情报，免费报告,行业咨询,数据等，是中国知名的研究报告提供商。

报告目录：

第一部分 集成电路封装产业环境透视

第一章 中国集成电路封装行业发展背景

第一节 集成电路封装行业定义及分类

一、集成电路封装行业定义

二、集成电路封装行业产品大类

三、集成电路封装行业特性分析

- 1、行业周期性
- 2、行业区域性
- 3、行业季节性

#### 四、集成电路封装行业在集成电路产业中的地位分析

#### 第二节 集成电路封装行业政策环境分析

- 一、行业管理体制
- 二、行业相关政策

#### 第三节 集成电路封装行业经济环境分析

- 一、国际宏观经济环境及影响分析
- 二、国内宏观经济环境及影响分析

#### 第四节 集成电路封装行业技术环境分析

- 一、集成电路封装技术演进分析
- 二、集成电路封装形式应用领域
- 三、集成电路封装工艺流程分析
- 四、集成电路封装行业新技术动态

### 第二部分 集成电路行业深度分析

#### 第二章 中国集成电路产业发展分析

##### 第一节 集成电路产业发展状况

- 一、集成电路产业链简介
- 二、集成电路产业发展现状分析

- 1、行业发展势头良好
- 2、行业技术水平快速提升
- 3、行业竞争力仍有待加强
- 4、产业结构进一步优化

##### 三、集成电路产业区域发展格局分析

- 1、三大区域集聚发展格局业已形成
- 2、整体呈现“一轴一带”的分布特征
- 3、产业整体将“有聚有分，东进西移”

##### 四、集成电路产业面临的发展机遇

- 1、产业政策环境进一步向好
- 2、战略性新兴产业将加速发展

3、资本市场将为企业融资提供更多机会

## 五、集成电路产业面临的主要问题

1、规模小

2、创新不足

3、价值链整合不够

4、产业链不完善

## 六、集成电路产业“十三五”发展规划预测

### 第二节 集成电路设计业发展状况

一、集成电路设计业发展概况

二、集成电路设计业发展特征

1、产业规模持续扩大

2、质量上升数量下降

3、企业规模持续扩大

4、技术能力大幅提升

三、集成电路设计业发展隐忧

四、集成电路设计业新发展策略

五、集成电路设计业“十三五”发展预测

### 第三节 集成电路制造业发展状况

一、集成电路制造业发展现状分析

1、集成电路制造业发展总体概况

2、集成电路制造业发展主要特点

3、集成电路制造业规模及财务指标分析

二、集成电路制造业经济指标分析

1、集成电路制造业主要经济效益影响因素

2、集成电路制造业经济指标分析

3、不同规模企业主要经济指标比重变化情况分析

4、不同性质企业主要经济指标比重变化情况分析

5、不同地区企业经济指标分析

三、集成电路制造业供需平衡分析

1、全国集成电路制造业供给情况分析

(1) 全国集成电路制造业总产值分析

(2) 全国集成电路制造业产成品分析

- 2、全国集成电路制造业需求情况分析
  - (1) 全国集成电路制造业销售产值分析
  - (2) 全国集成电路制造业销售收入分析
- 3、全国集成电路制造业产销率分析
- 四、集成电路制造业“十三五”发展预测

### 第三章 中国集成电路封装行业发展分析

#### 第一节 中国集成电路封装行业整体发展情况

- 一、集成电路封装行业规模分析
- 二、集成电路封装行业发展现状分析
- 三、集成电路封装行业利润水平分析
- 四、大陆厂商与业内领先厂商的技术比较
- 五、集成电路封装行业影响因素分析
  - 1、有利因素
  - 2、不利因素
- 六、集成电路封装行业发展趋势及前景预测
  - 1、发展趋势分析
  - 2、前景预测

#### 第二节 半导体封测技术分析

- 一、中国半导体行业发展概况
- 二、半导体行业景气预测
- 三、半导体封装技术分析
  - 1、封装环节产值逐年成长
  - 2、封装环节外包是未来发展趋势

#### 第三节 集成电路封装类专利分析

- 一、专利分析样本构成
  - 1、数据库选择
  - 2、检索方式
- 二、封装类专利分析
  - 1、专利公开年度趋势
  - 2、国内外专利公开趋势对比
  - 3、国内专利公开主要省市分布

4、IPC技术分类趋势分布

5、主要权利人分布情况

#### 第四节 集成电路封装过程部分技术问题探讨

##### 一、集成电路封装开裂产生原因分析及对策

1、封装开裂的影响因素分析

2、管控影响开裂的因素的方法分析

##### 二、集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策

1、产生芯片弹坑问题的因素分析

2、预防芯片弹坑问题产生的方法

### 第四章 我国集成电路封装行业整体运行指标分析

#### 第一节 2013-2015年中国集成电路封装行业总体分析

一、企业数量结构分析

二、人员规模状况分析

三、行业资产规模分析

四、行业市场规模分析

#### 第二节 2013-2015年中国集成电路封装行业财务指标

##### 一、行业盈利能力分析

1、我国集成电路封装行业利润率

2、我国集成电路封装行业成本费用利润率

3、我国集成电路封装行业亏损面

##### 二、行业偿债能力分析

1、我国集成电路封装行业资产负债比率

2、我国集成电路封装行业利息保障倍数

##### 三、行业营运能力分析

1、我国集成电路封装行业应收帐款周转率

2、我国集成电路封装行业总资产周转率

3、我国集成电路封装行业流动资产周转率

##### 四、行业发展能力分析

1、我国集成电路封装行业总资产增长率

2、我国集成电路封装行业利润总额增长率

3、我国集成电路封装行业主营业务收入增长率

#### 4、我国集成电路封装行业资本保值增值率

### 第五章 中国集成电路封装行业市场需求分析

#### 第一节 集成电路市场分析

##### 一、集成电路市场规模

##### 二、集成电路市场结构分析

##### 1、集成电路市场产品结构分析

##### 2、集成电路市场应用结构分析

##### 三、集成电路市场竞争格局

##### 四、集成电路国内市场自给率

##### 五、集成电路市场发展预测

#### 第二节 集成电路封装行业需求分析

##### 一、计算机领域对行业的需求分析

##### 1、计算机市场发展现状

##### 2、集成电路在计算机领域的应用

##### 3、计算机领域对行业需求的拉动

##### 二、消费电子领域对行业的需求分析

##### 1、消费电子市场发展现状

##### 2、集成电路在消费电子领域的应用

##### 3、消费电子领域对行业需求的拉动

##### 三、通信设备领域对行业的需求分析

##### 1、通信设备市场发展现状

##### 2、集成电路在通信设备领域的应用

##### 3、通信设备领域对行业需求的拉动

##### 四、工控设备领域对行业的需求分析

##### 1、工控设备市场发展现状

##### 2、集成电路在工控设备领域的应用

##### 3、工控设备领域对行业需求的拉动

##### 五、汽车电子领域对行业的需求分析

##### 1、汽车电子市场发展现状

##### 2、集成电路在汽车电子领域的应用

##### 3、汽车电子领域对行业需求的拉动

## 六、其他应用领域对行业的需求分析

### 第三部分 集成电路封装行业市场全景调研

#### 第六章 中国集成电路封装行业产品市场分析

##### 第一节 集成电路封装行业BGA产品市场分析

###### 一、BGA封装技术

###### 二、BGA产品主要应用领域

###### 三、BGA产品需求拉动因素

###### 四、BGA产品市场应用现状分析

###### 五、BGA产品市场前景展望

##### 第二节 集成电路封装行业SIP产品市场分析

###### 一、SIP封装技术

###### 二、SIP产品主要应用领域

###### 三、SIP产品需求拉动因素

###### 四、SIP产品市场应用现状分析

###### 五、SIP产品市场前景展望

##### 第三节 集成电路封装行业SOP产品市场分析

###### 一、SOP封装技术

###### 二、SOP产品主要应用领域

###### 三、SOP产品市场发展现状

###### 四、SOP产品市场前景展望

##### 第四节 集成电路封装行业QFP产品市场分析

###### 一、QFP封装技术

###### 二、QFP产品主要应用领域

###### 三、QFP产品市场发展现状

###### 四、QFP产品市场前景展望

##### 第五节 集成电路封装行业QFN产品市场分析

###### 一、QFN封装技术

###### 二、QFN产品主要应用领域

###### 三、QFN产品市场发展现状

###### 四、QFN产品市场前景展望

##### 第六节 集成电路封装行业MCM产品市场分析

## 一、MCM封装技术水平概况

### 1、概念简介

### 2、MCM封装分类

## 二、MCM产品主要应用领域

## 三、MCM产品需求拉动因素

## 四、MCM产品市场发展现状

## 五、MCM产品市场前景展望

## 第七节 集成电路封装行业CSP产品市场分析

### 一、CSP封装技术水平概况

#### 1、概念简介

#### 2、CSP产品特点

#### 3、CSP封装分类

### 二、CSP产品主要应用领域

### 三、CSP产品市场发展现状

### 四、CSP产品市场前景展望

## 第八节 集成电路封装行业其他产品市场分析

### 一、晶圆级封装市场分析

#### 1、概念简介

#### 2、产品特点

#### 3、主要应用领域

#### 4、市场规模与主要供应商

#### 5、前景展望

### 二、覆晶/倒封装市场分析

#### 1、概念简介

#### 2、产品特点

#### 3、市场前景

### 三、3D封装市场分析

#### 1、概念简介

#### 2、封装方法

#### 3、封装特点

#### 4、发展现状与前景

## 第四部分 集成电路封装行业竞争格局分析

### 第七章 集成电路封装行业市场竞争分析

#### 第一节 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析

##### 一、现有竞争者之间的竞争

##### 二、上游议价能力分析

##### 三、下游议价能力分析

##### 四、行业潜在进入者分析

##### 五、替代品风险分析

#### 第二节 集成电路封装行业国际竞争格局分析

##### 一、国际集成电路封装市场总体发展状况

##### 二、国际集成电路封装市场竞争状况分析

##### 三、国际集成电路封装市场发展趋势分析

##### 1、封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本

##### 2、主板材料的变化趋势

##### 四、跨国企业在华市场竞争力分析

#### 第三节 集成电路封装行业国内竞争格局分析

##### 一、国内集成电路封装行业竞争格局分析

##### 二、国内集成电路封装行业集中度分析

##### 1、行业销售收入集中度分析

##### 2、行业利润集中度分析

##### 3、行业工业总产值集中度分析

##### 三、中国集成电路封装行业国际竞争力分析

## 第八章 2016年集成电路封装行业领先企业经营形势分析

### 第一节 杭州士兰微电子股份有限公司

#### 一、企业发展简况分析

#### 二、企业盈利能力分析

#### 三、企业运营能力分析

#### 四、企业偿债能力分析

#### 五、企业发展能力分析

#### 六、企业集成电路相关业务分析

#### 七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

## 第二节 天水华天科技股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

## 第三节 威讯联合半导体（北京）有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

## 第四节 上海中芯国际集成电路制造有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

## 第五节 吉林华微电子股份有限公司

一、企业发展简况分析

- 二、企业盈利能力分析
- 三、企业运营能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业发展能力分析
- 六、企业集成电路相关业务分析
- 七、企业业务扩张及融资渠道分析
- 八、企业经营状况优劣势分析
- 九、企业最新发展动向分析

#### 第六节 飞思卡尔半导体（中国）有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业盈利能力分析
- 三、企业运营能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业发展能力分析
- 六、企业集成电路相关业务分析
- 七、企业经营状况优劣势分析
- 八、企业最新发展动向分析

#### 第七节 江苏长电科技股份有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业盈利能力分析
- 三、企业运营能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业发展能力分析
- 六、企业集成电路相关业务分析
- 七、企业业务扩张及融资渠道分析
- 八、企业经营状况优劣势分析
- 九、企业最新发展动向分析

#### 第八节 南通富士通微电子股份有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业盈利能力分析
- 三、企业运营能力分析
- 四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

#### 第九节 无锡华润安盛科技有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

#### 第十节 江阴苏阳电子股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

#### 第十一节 深圳市赛意法微电子有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

## 第十二节 南通华达微电子集团有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业盈利能力分析
- 三、企业运营能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业发展能力分析
- 六、企业集成电路相关业务分析
- 七、企业经营状况优劣势分析
- 八、企业最新发展动向分析

## 第十三节 深圳安博电子有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业盈利能力分析
- 三、企业运营能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业发展能力分析
- 六、企业集成电路相关业务分析
- 七、企业经营状况优劣势分析
- 八、企业最新发展动向分析

## 第十四节 力成科技股份有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业盈利能力分析
- 三、企业运营能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业发展能力分析
- 六、企业集成电路相关业务分析
- 七、企业业务扩张及融资渠道分析
- 八、企业经营状况优劣势分析
- 九、企业最新发展动向分析

## 第十五节 乐山无线电股份有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业盈利能力分析
- 三、企业运营能力分析

- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业发展能力分析
- 六、企业集成电路相关业务分析
- 七、企业业务扩张及融资渠道分析
- 八、企业经营状况优劣势分析
- 九、企业最新发展动向分析

#### 第十六节 广东风华芯电科技股份有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业盈利能力分析
- 三、企业运营能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业发展能力分析
- 六、企业集成电路相关业务分析
- 七、企业业务扩张及融资渠道分析
- 八、企业经营状况优劣势分析
- 九、企业最新发展动向分析

#### 第十七节 深圳中星华电子有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业盈利能力分析
- 三、企业运营能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业发展能力分析
- 六、企业集成电路相关业务分析
- 七、企业经营状况优劣势分析
- 八、企业最新发展动向分析

#### 第十八节 上海先进半导体制造股份有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业盈利能力分析
- 三、企业运营能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业发展能力分析
- 六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

#### 第十九节 深圳市矽格半导体科技有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

#### 第二十节 智瑞达科技（苏州）有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

#### 第二十一节 深圳电通纬创微电子股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

## 第二十二节 上海松下半导体有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业盈利能力分析
- 三、企业运营能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业发展能力分析
- 六、企业集成电路相关业务分析
- 七、企业经营状况优劣势分析
- 八、企业最新发展动向分析

## 第二十三节 苏州晶方半导体科技股份有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业盈利能力分析
- 三、企业运营能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业发展能力分析
- 六、企业集成电路相关业务分析
- 七、企业业务扩张及融资渠道分析
- 八、企业经营状况优劣势分析
- 九、企业最新发展动向分析

## 第二十四节 沛顿科技（深圳）有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业盈利能力分析
- 三、企业运营能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业发展能力分析
- 六、企业集成电路相关业务分析
- 七、企业经营状况优劣势分析
- 八、企业最新发展动向分析

## 第二十五节 矽格微电子（无锡）有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业盈利能力分析
- 三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

第二十六节 浙江东和电子科技有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

第二十七节 气派科技股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

第二十八节 山东凯胜电子股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

第二十九节 恒汇电子科技有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

第三十节 深圳市中洋田电子技术股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

第五部分 集成电路封装行业发展前景展望

第九章 2016-2022年集成电路封装行业前景及趋势预测

第一节 2016-2022年集成电路封装市场发展前景

一、2016-2022年集成电路封装市场发展潜力

二、2016-2022年集成电路封装市场发展前景展望

三、2016-2022年集成电路封装细分行业发展前景分析

第二节 2016-2022年集成电路封装市场发展趋势预测

一、2016-2022年集成电路封装行业发展趋势

1、技术发展趋势分析

2、产品发展趋势分析

### 3、产品应用趋势分析

#### 二、2016-2022年集成电路封装市场规模预测

##### 1、集成电路封装行业市场容量预测

##### 2、集成电路封装行业销售收入预测

#### 三、2016-2022年集成电路封装行业应用趋势预测

#### 四、2016-2022年细分市场发展趋势预测

### 第三节 2016-2022年中国集成电路封装行业供需预测

#### 一、2016-2022年中国集成电路封装行业供给预测

#### 二、2016-2022年中国集成电路封装行业需求预测

#### 三、2016-2022年中国集成电路封装行业供需平衡预测

### 第四节 影响企业生产与经营的关键趋势

## 第十章 2016-2022年集成电路封装行业投资价值评估分析

### 第一节 集成电路封装行业投资特性分析

#### 一、集成电路封装行业进入壁垒分析

#### 二、集成电路封装行业盈利因素分析

#### 三、集成电路封装行业盈利模式分析

### 第二节 2016-2022年集成电路封装行业发展的影响因素

#### 一、有利因素

#### 二、不利因素

### 第三节 2016-2022年集成电路封装行业投资价值评估

#### 一、行业投资效益分析

#### 二、产业发展的空白点分析

#### 三、投资回报率比较高的投资方向

#### 四、新进入者应注意的障碍因素

## 第十一章 2016-2022年集成电路封装行业投资机会与风险防范

### 第一节 集成电路封装行业投融资情况

#### 一、行业资金渠道分析

#### 二、固定资产投资分析

#### 三、兼并重组情况分析

#### 四、集成电路封装行业投资现状分析

## 第二节 2016-2022年集成电路封装行业投资机会

### 一、产业链投资机会

### 二、细分市场投资机会

### 三、重点区域投资机会

### 四、集成电路封装行业投资机遇

## 第三节 2016-2022年集成电路封装行业投资风险及防范

### 一、政策风险及防范

### 二、技术风险及防范

### 三、供求风险及防范

### 四、宏观经济波动风险及防范

### 五、关联产业风险及防范

### 六、产品结构风险及防范

### 七、其他风险及防范

## 第四节 中国集成电路封装行业投资建议

### 一、集成电路封装行业未来发展方向

### 二、集成电路封装行业主要投资建议

### 三、中国集成电路封装企业融资分析

#### 1、中国集成电路封装企业IPO融资分析

#### 2、中国集成电路封装企业再融资分析

## 第六部分 集成电路封装行业发展战略研究

### 第十二章 2016-2022年集成电路封装行业面临的困境及对策

#### 第一节 2015年集成电路封装行业面临的困境

#### 第二节 集成电路封装企业面临的困境及对策

##### 一、重点集成电路封装企业面临的困境及对策

##### 二、中小集成电路封装企业发展困境及策略分析

##### 三、国内集成电路封装企业的出路分析

#### 第三节 中国集成电路封装行业存在的问题及对策

##### 一、中国集成电路封装行业存在的问题

##### 二、集成电路封装行业发展的建议对策

###### 1、把握国家投资的契机

###### 2、竞争性战略联盟的实施

### 3、企业自身应对策略

#### 三、市场的重点客户战略实施

- 1、实施重点客户战略的必要性
- 2、合理确立重点客户
- 3、重点客户战略管理
- 4、重点客户管理功能

## 第十三章 集成电路封装行业案例分析研究

### 第一节 集成电路封装行业并购重组案例分析

- 一、集成电路封装行业并购重组成功案例分析
- 二、集成电路封装行业并购重组失败案例分析
- 三、经验借鉴

### 第二节 集成电路封装行业经营管理案例分析

- 一、集成电路封装行业经营管理成功案例分析
- 二、集成电路封装行业经营管理失败案例分析
- 三、经验借鉴

### 第三节 集成电路封装行业营销案例分析

- 一、集成电路封装行业营销成功案例分析
- 二、集成电路封装行业营销失败案例分析
- 三、经验借鉴

## 第十四章 集成电路封装行业发展战略研究

### 第一节 集成电路封装行业发展战略研究

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略
- 七、竞争战略规划

### 第二节 对我国集成电路封装品牌的战略思考

- 一、集成电路封装品牌的重要性

- 二、集成电路封装实施品牌战略的意义
- 三、集成电路封装企业品牌的现状分析
- 四、我国集成电路封装企业的品牌战略
- 五、集成电路封装品牌战略管理的策略

### 第三节 集成电路封装经营策略分析

- 一、集成电路封装市场细分策略
- 二、集成电路封装市场创新策略
- 三、品牌定位与品类规划
- 四、集成电路封装新产品差异化战略

### 第四节 集成电路封装行业发展战略研究

- 一、2015年集成电路封装行业投资战略
- 二、2016-2022年集成电路封装行业投资战略
- 三、2016-2022年细分行业投资战略

## 第十五章 中国集成电路封装行业发展分析及建议

### 第一节 集成电路封装行业投资特性分析

#### 一、集成电路封装行业进入壁垒

- 1、技术壁垒
- 2、资金壁垒
- 3、人才壁垒
- 4、严格的客户认证制度

#### 二、集成电路封装行业盈利模式

#### 三、集成电路封装行业盈利因素

### 第二节 集成电路封装行业投资兼并与重组分析

- 一、集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况
- 二、国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析
- 三、国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析
  - 1、通富微电公司投资兼并与重组分析
  - 2、华天科技公司投资兼并与重组分析
  - 3、长电科技公司投资兼并与重组分析
- 四、集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析

### 第三节 集成电路封装行业投融资分析

## 一、电子发展基金对集成电路产业的扶持分析

### 1、电子发展基金对集成电路产业的扶持情况

### 2、电子发展基金对集成电路产业的扶持建议

## 二、集成电路封装行业融资成本分析

## 三、半导体行业资本支出分析

## 第四节 集成电路封装行业发展建议

### 一、集成电路封装行业投资机会分析

### 二、集成电路封装行业投资风险分析

### 三、集成电路封装行业发展建议

## 图表目录：

图表：集成电路封装行业生命周期

图表：集成电路封装行业产品分类

图表：我国集成电路封装企业地区分布

图表：集成电路封装行业主要政策分析

图表：2013-2015年全球主要经济体经济增长速度

图表：2013-2015年各项全球PMI指数变动情况

图表：2013-2015年中国GDP增长趋势图

图表：封装技术的演进

图表：各种集成电路封装形式应用领域

图表：集成电路封装工艺流程

图表：集成电路产业链示意图

图表：2013-2015年我国集成电路产业结构分析

图表：中国集成电路产业长三角地区分布概况

图表：未来集成电路产业的整体空间布局特点分析

图表：2013-2015年我国集成电路设计市场销售额走势

图表：集成电路设计业新发展策略

图表：集成电路制造业发展主要特点分析

图表：2013-2015年集成电路制造业规模分析

图表：2013-2015年中国集成电路制造业盈利能力分析

图表：2013-2015年中国集成电路制造业运营能力分析

图表：2013-2015年中国集成电路制造业偿债能力分析

图表：切筋凸模的一般设计方法

图表：管控影响开裂的因素的方法分析

图表：2013-2015年中国集成电路销售收入及增长情况

图表：2013-2015年中国集成电路市场产品结构图

图表：2013-2015年中国集成电路市场应用结构图

图表：2013-2015年中国集成电路市场品牌竞争结构

图表：2016-2022年全球IT支出预测

图表：2016-2022年亚太地区IT支出预测

图表：2013-2015年中国通信设备制造业主要经济指标

图表：集成电路封装技术在医疗电子领域应用分析

图表：中国集成电路封装测试行业企业类别

图表：集成电路封装行业上游议价能力分析

图表：集成电路封装行业下游议价能力分析

图表：集成电路封装行业潜在进入者威胁分析

图表：集成电路封装行业替代品威胁分析

图表：全球各封装技术产品产量构成表

图表：全球前十大集成电路封装测试企业排名

图表：各种电子产品的介电常数

图表：DNP将部件内置底板“B2it”薄型化

图表：“MEGTRON4”的电气特性和耐热性

图表：2013-2015年台湾矽品公司简明损益表

图表：2013-2015年中国十大集成电路封装测试企业

图表：BGA封装技术特点分析

图表：BGA封装技术分类

图表：PBGA（塑料焊球阵列）封装

图表：CMMB应用市场结构

图表：CMMB芯片产业链示意图

图表：带有倒装、打线等多种技术的3D SIP封装示意图

图表：SIP产品应用领域分析

图表：SOP封装产品

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/T61651NLM3.html>